



HeatSORB™ 热管理材料

手持式装置的设计越来越轻薄。因此，装置内部件间的空间越来越狭小。

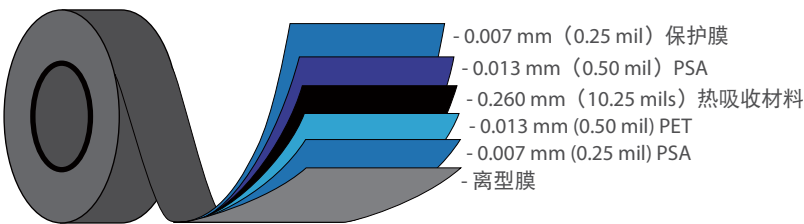
不仅如此，电子设备对效能提升的追求以及将金属选为设计材料的主流趋势，使热管理成为一项重大挑战。HeatSORB™专利相变材料通过储存热能延迟温升，从而帮助设备保持冷却，解决热管理问题。

有效热管理同样重要，与使用者的体验息息相关。低效热管理会导致：

- 热量疏导（芯片降频）
- 装置死机
- 设备发热对使用者造成的不适

HeatSORB材料可提高热效率，效果远超铜箔、石墨片及热管等传统均热材料。

HeatSORB是为手持电子设备市场而研发，在有限空间内满足高热焓值、以及长期可靠热管理的应用需求。



热管理问题通常出现在以下部件上：

- SoC（片上系统）
- PMIC（电源管理IC）
- 功率放大器
- 图像传感器
- 显示屏

已解决以下热管理问题：

- 吸收热量浪涌，延迟温升
- 长期可靠

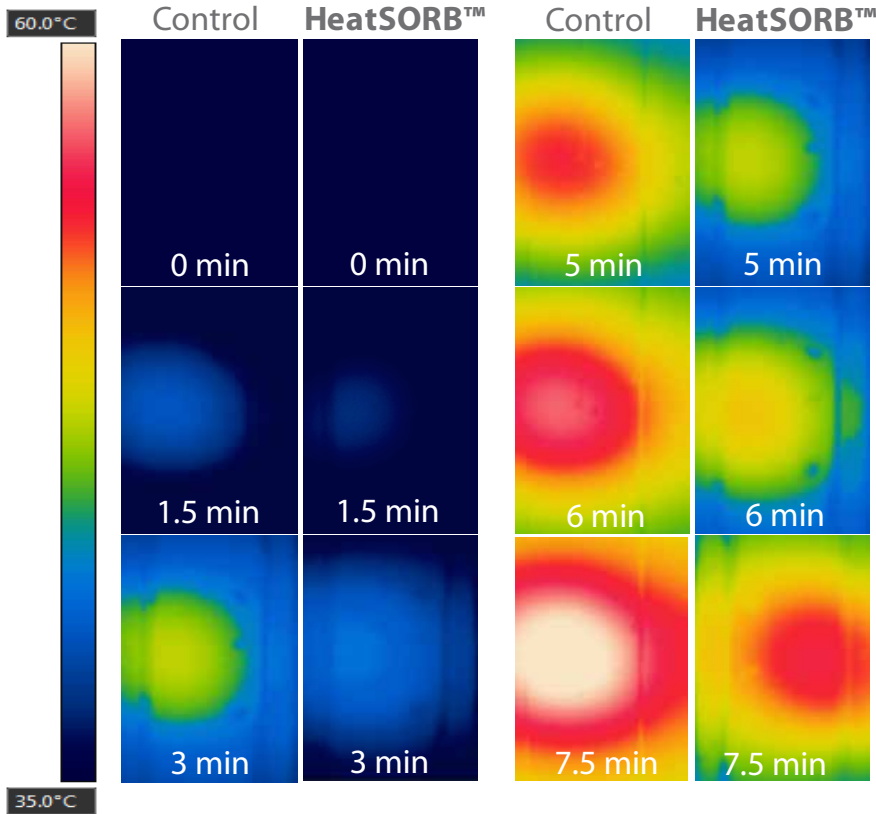
相变原理

HeatSORB使用了一种物态转变时需要大量热焓的固定化化合物。

相变过程中，HeatSORB吸收热量从而防止其传导到电子元器件中。



HeatSORB™ 热管理材料



热显像仪用来记录升温状况



热成像相机

HeatSORB

(75mm x 125mm x 0.3mm)

铝板

(75mm x 125mm x 0.3mm)

热源

(50.8mm x 50.8mm)

输出功率: 10W

HeatSORB™热循环分析

